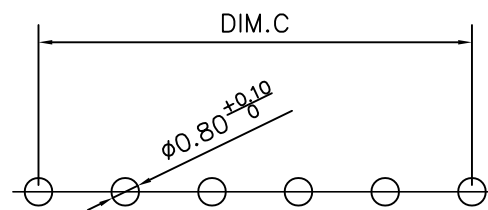
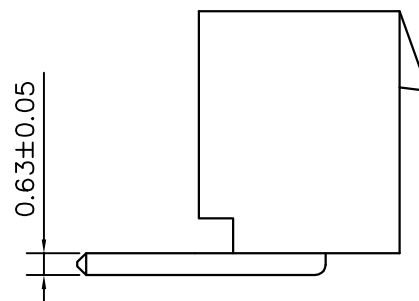
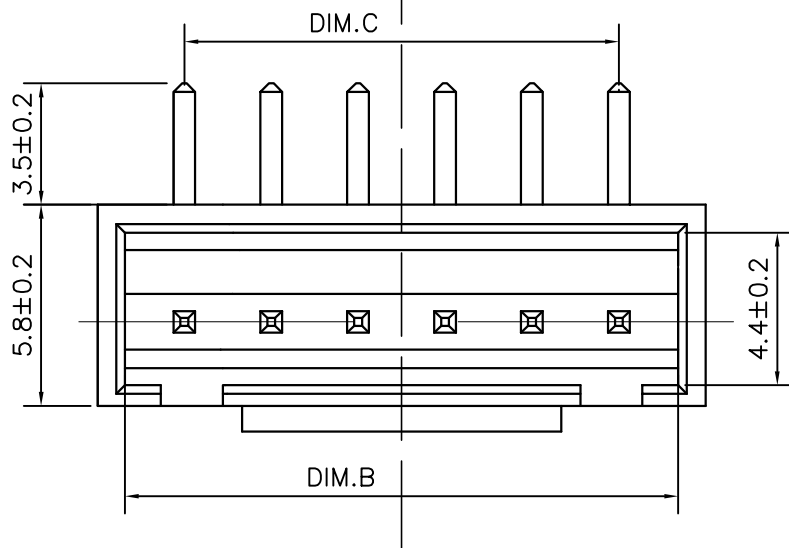
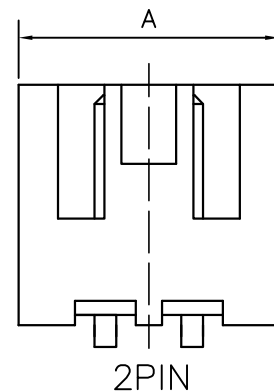
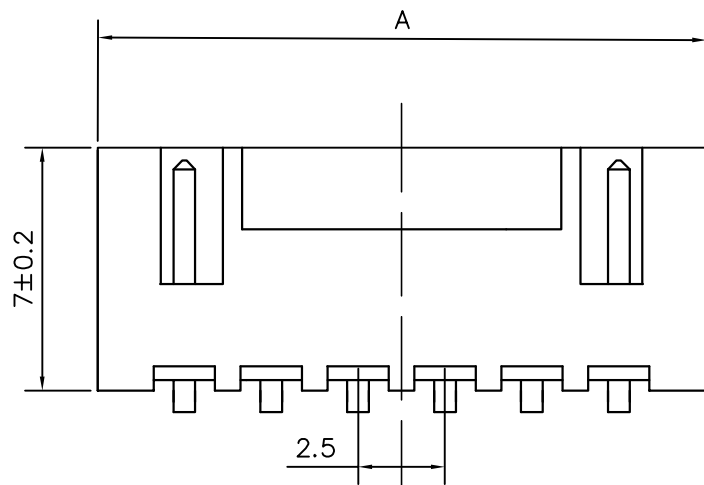


标 记  
MARKECN编号/变更内容  
ECN NO/DEFINITION修 改  
REVISE日 期  
DATE核 准  
APPROVE

PCB LAYOUT

Pin	DIM A	DIM B	DIM C
2	7.50	6.10	2.50
3	10.00	8.60	5.00
4	12.50	11.10	7.50
5	15.00	13.60	10.00
6	17.50	16.10	12.50
7	20.00	18.60	15.00
8	22.50	21.10	17.50
9	25.00	23.60	20.00
10	27.50	26.10	22.50
11	30.00	28.60	25.00
12	32.50	31.10	27.50
13	35.00	33.60	30.00
14	37.50	36.10	32.50
15	40.00	38.60	35.00

技术要求:

适应基板厚度: 1.2mm~1.6mm

温度范围: -25°C~85°C

额定电压: 250V AC/DC

额定电流: 3A

接触电阻: ≤0.01Ω

绝缘电阻: ≥1000MΩ

耐 压: 1000V AC/minute

2	插针	铜	镀锡	
1	底座	PA66	白色	
序号	品名	材质	电镀/颜色	备注



深圳市虹成电子有限公司

品名 TITLE	针座
料号 PART NO	HC-XHB-4AW-TW

GENERAL TOLERANCES  
(UNLESS SPECIFIED)比 例  
SCALE

1:1

X.X ±0.35 X' ±3.00'

单 位  
UNIT

MM

X.XX ±0.25 X.X' ±2.00'

张 数  
PART NO

1 OF 1

X.XXX ±0.15 X.XX' ±1.00'

版 本  
REV

A

制 图 DRAW	AhYe	夏操云
审 核 CHECKED	赵亮亮	
批 准 APPROVE		

